USP-8B06(DAF) : 許容損失 / Power Dissipation

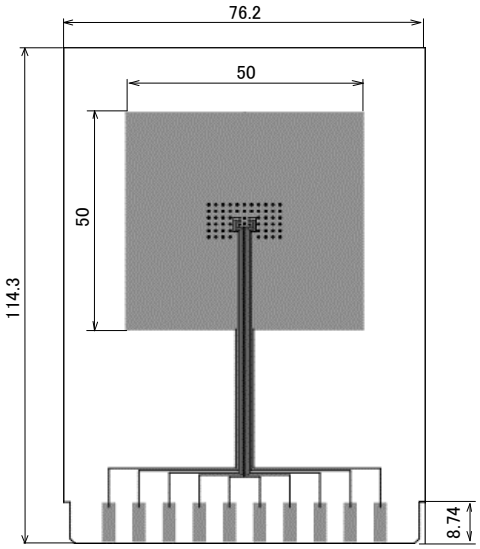
許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

Allowable loss varies depending on mounting conditions, etc.,
so the data below is for reference only based on the following mounting conditions.

1. 測定条件 (参考データ) / Test Result (Referential Data)

測定条件: 基板実装状態
雰囲気: 自然対流
実装: Pbフリーはんだ
実装基板: 基板76.2mm×114.3mm(片面8700mm2)に対して銅箔面積
1層目: 50mm×50mm（放熱板と接続有）
2層目: 70mm×70mm（放熱板と接続有）
3層目: 70mm×70mm（放熱板と接続有）
4層目: 50mm×50mm（放熱板と接続有）
基板材質: ガラスエポキシ(FR-4)
板厚: 1.6mm
スルーホール: ホール径 0.2mm 60個

Test Conditions : being mounted on a FR-4 PCB
Atmosphere : Naturally Convection
Solder : Pb Free Solder
PCB Size : 76.2mm×114.3mm (One side-8700mm2)
Copper foil area : Layer 1 50mm × 50mm (connected to heat sink)
Layer 2 70mm × 70mm (connected to heat sink)
Layer 3 70mm × 70mm (connected to heat sink)
Layer 4 50mm × 50mm (connected to heat sink)
PCB Material : Glass Epoxy (FR-4)
PCB Thickness : 1.6mm
Through Hole : Via.0.2mm 60pcs

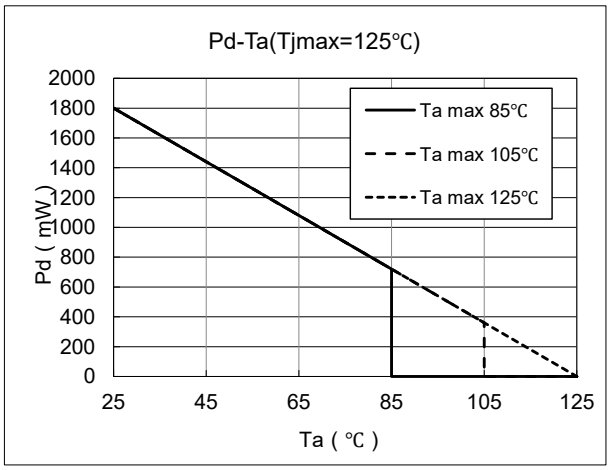


評価基板レイアウト / PCB design (Unit:mm)

2. 許容損失 - 周囲温度特性 / Power Dissipation-Ambient Temperature Characteristic

Tjmax = 125℃

Ta (℃)	Pd (mW)			θja (℃/W)
	Ta max 85℃	Ta max 105℃	Ta max 125℃	
25	1800	1800	1800	55.6
85	720	720	720	
105	0	360	360	
125	0	0	0	



USP-8B06(JESD51-7): 許容損失 / Power Dissipation

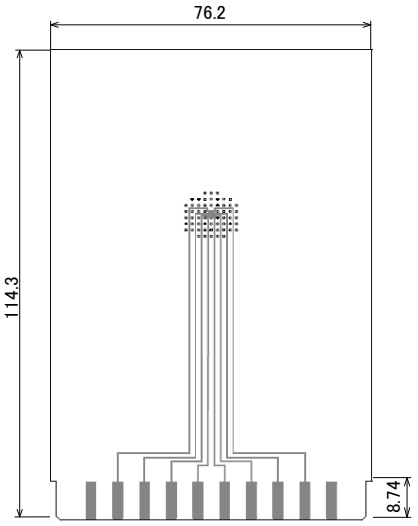
許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

Allowable loss varies depending on mounting conditions, etc.,
so the data below is for reference only based on the following mounting conditions.

1. 測定条件 (参考データ) / Test Result (Referential Data)

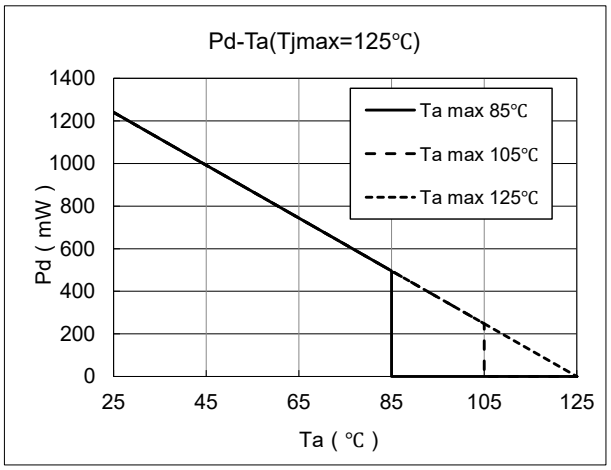
測定条件: 基板実装状態
雰囲気: 自然対流
実装: Pbフリーはんだ
実装基板: 基板76.2mm×114.3mm(片面8700mm2)に対して銅箔面積
1層目: 銅箔無し（信号層の為）
2層目: 70mm×70mm（放熱板と接続有）
3層目: 70mm×70mm（放熱板と接続有）
4層目: 銅箔無し（信号層の為）
基板材質: ガラスエポキシ(FR-4)
板厚: 1.6mm
スルーホール: ホール径 0.2mm 60個

Test Conditions : being mounted on a FR-4 PCB
Atmosphere : Naturally Convection
Solder : Pb Free Solder
PCB Size : 76.2mm×114.3mm (One side-8700mm2)
Copper foil area : Layer 1 No copper foil (signal layer)
Layer 2 70mm × 70mm (connected to heat sink)
Layer 3 70mm × 70mm (connected to heat sink)
Layer 4 No copper foil (signal layer)
PCB Material : Glass Epoxy (FR-4)
PCB Thickness : 1.6mm
Through Hole : Via.0.2mm 60pcs



評価基板レイアウト / PCB design (Unit:mm)

2. 許容損失 - 周囲温度特性 / Power Dissipation-Ambient Temperature Characteristic

Tjmax = 125℃

Ta (℃)	Pd (mW)			θja (℃/W)
	Ta max 85℃	Ta max 105℃	Ta max 125℃	
25	1240	1240	1240	80.6
85	496	496	496	
105	0	248	248	
125	0	0	0